

# 第二届高性能陶瓷基板关键材料技术大会暨电子陶瓷技术创新峰会

半导体及电子信息产业的快速发展对核心材料的性能提出了更高要求。电子陶瓷作为具有电、磁、热、机械等多功能耦合特性的关键基础材料，广泛应用于电容器、滤波器、传感器及封装基板等核心元件。其中，陶瓷基板是电子陶瓷在功率半导体封装领域的重要产品形态，其导热性能、机械强度、可靠性和精密程度直接决定了终端产品的性能与寿命。

当前，全球高端陶瓷基板市场仍由日美等国家主导，我国虽在基础研究及初步产业化方面取得一定突破，但在产业化规模、材料性能稳定性、复杂工艺技术及设备等方面仍然落后，国产替代需求迫切。同时，电子陶瓷在介质材料、压电陶瓷、微波陶瓷等细分领域的技术突破，也是推动封装与互联技术升级的关键。

在此背景下，中国粉体网将于 2026 年 7 月 17 日举办第二届高性能陶瓷基板关键材料技术大会暨电子陶瓷技术创新峰会，旨在汇聚国内外学术界、产业界及上下游企业，围绕陶瓷基板/电子陶瓷材料设计、制备工艺、性能检测、应用场景等核心议题展开深度交流，推动技术成果转化与产业链协同创新，助力我国电子陶瓷及陶瓷基板产业实现自主可控与高质量发展。

会议热诚欢迎行业专家、科研机构、技术团队、企业代表及投资机构参会，并诚邀相关单位展示最新技术成果与产品，共商产学研合作机遇，共绘产业发展蓝图。

## 时间：

2026年7月17日全天会议（7月16日全天报到）

## 地点：

无锡

## 主办单位：

中国粉体网

中粉会展

## 会议主题：

- 1、氮化铝、氮化硅等关键原材料技术突破
- 2、高导热陶瓷基板的设计与优化
- 3、陶瓷基板烧结工艺发展现状
- 4、流延等陶瓷基板成型技术及关键辅料发展现状
- 5、陶瓷基板性能突破方向探讨
- 6、陶瓷基板可靠性测试与寿命评估方法
- 7、陶瓷基板精密加工与微结构控制技术
- 8、先进封装发展现状
- 9、陶瓷基板在新能源汽车领域的创新应用
- 10、陶瓷基板金属化关键技术及材料进展
- 11、陶瓷基板在 AI、机器人、低空经济等领域的应用前瞻
- 12、陶瓷基板生产装备的国产化替代进展与突破
- 13、电子陶瓷材料体系与多功能化设计新进展
- 14、电子陶瓷成型、烧结与精密加工共性技术难题及对策

## 会议费用：

2800 元/人

包含会刊资料、茶歇、午餐、晚宴，不包含住宿费用

## 收款账户：

单位名称：粉材供应链管理（山东）有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司临沂北城支行

账户：226045899651

## 大会赞助：

（赞助详细内容请联系会务组了解）

- 1、协办赞助（含展位、企业致辞，会议期间 360 度环屏广告，视频播放，企业报告等）
- 2、晚宴赞助（含展位、晚宴 360 环屏大屏展示、晚宴致辞、主持人口播广告等）
- 3、其它赞助（会议礼品、环屏广告、侧屏广告，茶歇、椅背广告、胸牌广告赞助等）
- 4、展位展示（展示桌椅+展位背景墙广告）

## 会务组：

联系人：卢铭旗

手机：18669538053（微信同号）

邮箱：lumingqi@cnpowder.com



